



2021年1月29日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテスト
代表者名 代表取締役兼執行役員社長
吉田 芳明
(コード番号 6857 東証第1部)
問合せ先 取締役兼常務執行役員管理本部長
藤田 敦司
(TEL: 03-3214-7500)

(訂正)「2020年度第3四半期決算説明会資料」の一部訂正について

当社が2021年1月28日に公表いたしました「2020年度第3四半期決算説明会資料」について、一部正確性を欠く表現がございましたので、以下のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正箇所

14 ページ FY20 見通し(事業別) 半導体・部品テストシステム事業 <SoC テスタ> 右側中段

【訂正前】有機 EL 【訂正後】ディスプレイ

2. 訂正の内容

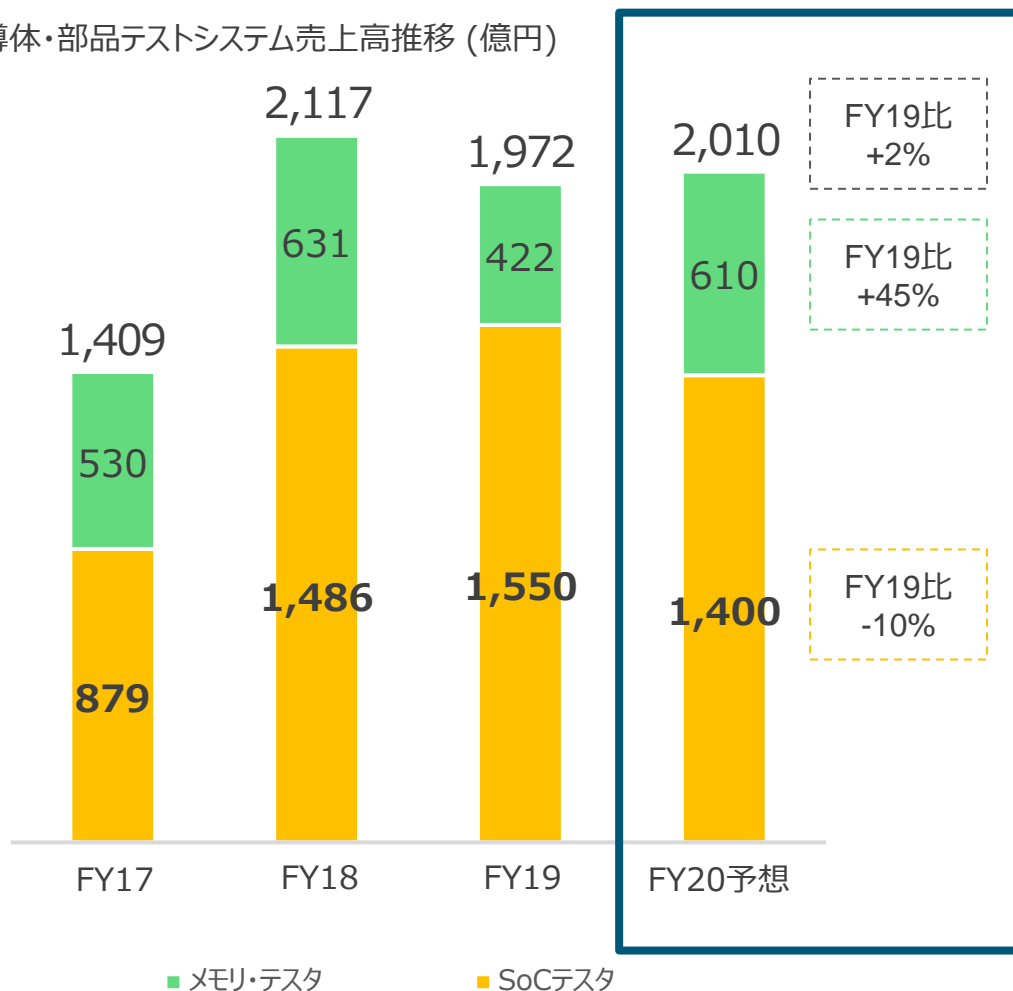
別紙をご参照ください。なお、訂正箇所は下線で表示しております。

以 上

FY20見通し（事業別）

訂正前

半導体・部品テストシステム売上高推移（億円）



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（10月予想比 +230億円）

- スマートフォンプレーヤー間の競争が、アプリケーション・プロセッサ(APU)やDDIなど関連するSoC半導体のテスト需要を押し上げ。今年度の売上予想を大幅修正
- DDIは有機ELパネル高機能化に伴うタッチセンサー組み込み対応需要も増加
- 4QもHPC/5Gスマートフォン関連中心の展開を想定

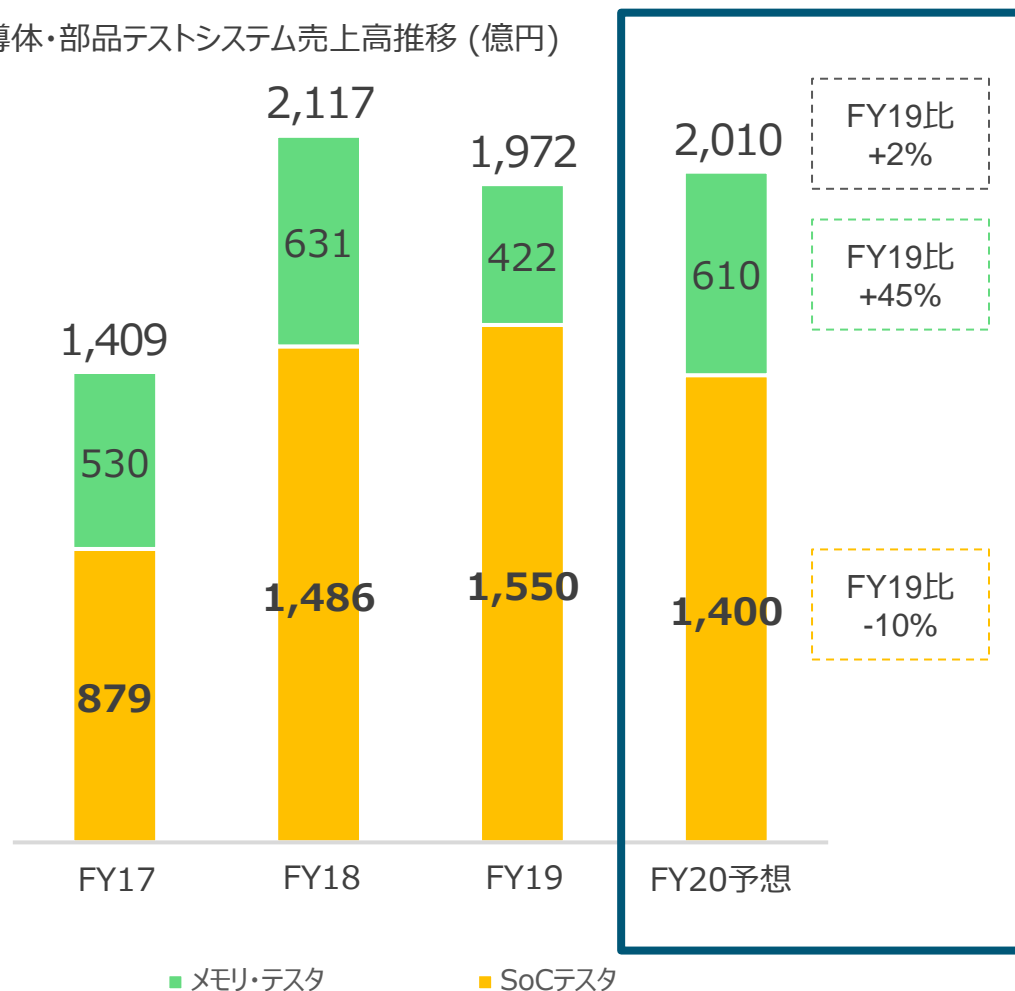
【現中計における売上拡大への取り組み進捗（予想）】

	FY15-17 平均	FY18-20 平均	増減率
SoCテスト	791億円	1,479億円	+87%
メモリ・テスト	353億円	554億円	+57%
合計	1,142億円	2,033億円	+78%

FY20見通し（事業別）

訂正後

半導体・部品テストシステム売上高推移（億円）



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（10月予想比 +230億円）

- スマートフォンプレーヤー間の競争が、アプリケーション・プロセッサ(APU)やDDIなど関連するSoC半導体のテスト需要を押し上げ。今年度の売上予想を大幅修正
- DDIはディスプレイパネル高機能化に伴うタッチセンサー組み込み対応需要も増加
- 4QもHPC/5Gスマートフォン関連中心の展開を想定

【現中計における売上拡大への取り組み進捗（予想）】

	FY15-17 平均	FY18-20 平均	増減率
SoCテスト	791億円	1,479億円	+87%
メモリ・テスト	353億円	554億円	+57%
合計	1,142億円	2,033億円	+78%